

## CH20M22 B SIM BK/OR 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Základní prvek modulárního krytu CH20M nabízí řadu výhod, které z něj činí vynikající volbu pro vaše typy použití. Díky speciálním výřezům pro sběrníkové kontakty a kontakty FE je obzvláště flexibilní a přizpůsobitelný.

Další výhodou je možnost laserového potisku krytu, který vám nabízí vysokou přesnost a individuální možnosti designu a konstrukce. K dispozici je také široká škála barev, díky nimž si pouzdro můžete navrhnout zcela podle svých představ.

Pouzdro CH20M je také vhodné pro standardní montážní lišty, což usnadňuje instalaci a integraci do stávajících systémů.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Skříň montážní lišty, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Boční prvek, příprava spojení mikro-SIM karta (3FF), Šířka: 22.5 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2743520000</a>
Typ	CH20M22 B SIM BK/OR 2010
GTIN (EAN)	4064675313168
Množství	10 items

## CH20M22 B SIM BK/OR 2010

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	108 mm	Hloubka (v palcích)	4.252 inch
Výška	109.3 mm	Výška (v palcích)	4.3031 inch
Šířka	22.5 mm	Šířka (v palcích)	0.8858 inch
Čistá hmotnost	40 g		

### Teploty

Okolní teplota	-25 °C...85 °C	Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66 GF 30
Skupina izolačního materiálu	I	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	Plast	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI

### Vlastnosti sestavy

Počet slotů pro zásuvky namontované sestavy, max.	6	Počet PCB, max.	1
Počet úrovní připojení, max.	3	Počet pólů, max.	24
Výška součástí na desce plošných spojů, max.	16.1 mm	Typ sestavy desky plošných spojů	dvoustranný

### Mechanické testy

Podle normy	DIN EN 61373:1999 (nárazy a vibrace)	
Zkušební podmínky	pět krytů instalovaných v řadě, dodatečná hmotnost 200 g na DPS	
Osvědčené osy	X, Y, Z	
Nárazový test	Obecné testovací rady	Všechny mechanické testy byly vyzkoušeny na vzorovém nastavení nebo z pohledu závislé regulace. Uvedené výsledky nenahrazují příslušné schvalovací testy. Jsou to jen orientační hodnoty.
	Zkušební kategorie	1
	Počet nárazů na osu	3in pozitivní a negativní směr
	Trvání nárazu	30 ms
	Zrychlení horizontální	30.00 m/s <sup>2</sup>
	Zrychlení vertikální	30.00 m/s <sup>2</sup>
	Zrychlení podélné	50.00 m/s <sup>2</sup>
Vibrační test	Zkušební kategorie	1B
	Trvání zkoušky	5 hodin na osu
	Efektivní zrychlení	7.9 m/s <sup>2</sup>

## Technické údaje

### Tepelné testy

Tepelné zkoušky	Obecné testovací rady	Všechny tepelné testy byly vyzkoušeny na vzorovém nastavení nebo z pohledu závislé regulace. Uvedené výsledky nenahrazují příslušné schvalovací testy. Jsou to jen orientační hodnoty.
	Zkušební podmínky	tři kryty instalované v řadě – bez rozestupu
	Zkušební osy	vodorovné
	Okolní teplota	70 °C
	Rozptýlení výkonu, max.	1.9 W
	Okolní teplota	60 °C
	Rozptýlení výkonu, max.	2.35 W
	Okolní teplota	40 °C
	Rozptýlení výkonu, max.	3.4 W
	Okolní teplota	20 °C
Rozptýlení výkonu, max.	4.5 W	

### Vlastnosti komponenty

Barva připínací patky	Oranžová	Výřez v ploše připínací patky jako příprava pro	Karta Micro SIM (3FF)
Počet úrovní připojení, max.	3		

### Typ konstrukce - požadavky IN

Tolerance for the PCB shape	±0.1 mm	PCB thickness	1.6 mm
Tolerance of circuit board thickness	±0,15 mm		

### Individualizační možnosti

Možná značení na míru	Ano	Proces objednávky specifický pro zákazníka	Viz pokyny pod zátěží
Alternativní barvy	Více na vyžádání	Možnosti zpracování	Zpracování laserem

### Obecné údaje

Barevný	černá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Nosná lišta	TS 35	Barevný graf (podobné)	RAL 9011
Encapsulation option	Ne		

### Důležitá poznámka

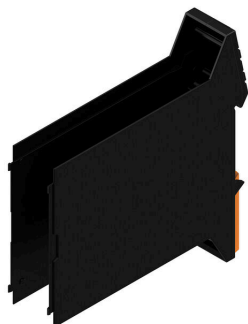
Informace o produktu	Tvary obvodových desek, zakázané zóny a další informace pro design obvodových desek je možné nalézt v kategorii technologie zapojování v odpovídajících záhlavích stažených souborů.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Klasifikace

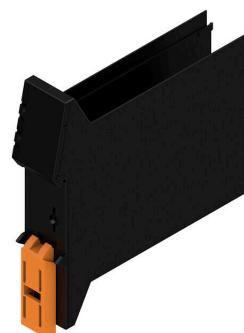
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

## Nákresy

### Obrázek výrobku



### Výhoda produktu



Základní prvek včetně výřezu SIM

### Rozměrový výkres

